

平成 25 年 3 月 6 日

各 位

会 社 名 シャープ株式会社
代表者名 取締役社長 奥田 隆 司
(コード番号 6753)

協業関係の強化に向けた第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 6 日開催の取締役会において、液晶パネルの供給先である SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (以下「サムスン電子」という。)との協業関係を強化するため、サムスン電子の日本法人であるサムスン電子ジャパン株式会社 (以下「サムスン電子ジャパン」という。)を割当先とした第三者割当による新株式の発行 (以下「本第三者割当増資」という。)を行い、サムスン電子ジャパンとの間で資本提携 (以下、「本資本提携」という。)を行う旨を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 本資本提携の概要

1. 本資本提携の目的及び理由

当社を取り巻く事業環境は、円高基調の恒常化やデジタル商品の急速なコモディティ化と市場価格の下落等に加え、リーマンショック後の先進国経済の停滞や、エコポイント終了後の国内液晶テレビ市場の急速な縮小、価格下落等による売上の減少といった厳しい状況が続き、当社は、平成 24 年 3 月期連結決算において、3,760 億円の当期純損失を計上するに至りました。こうした状況に対し、収益改善に向けて液晶事業・太陽電池事業の事業構造改革や、重点部門への人員シフトといった経営対策を推進し、平成 25 年 3 月期第 2 四半期連結会計期間の売上高は、ほぼ計画に沿った内容を達成することができました。他方、当社は、今後の中長期的な収益向上を目的に、新たな事業構造改革の一環として、固定資産やたな卸資産の評価損を計上するとともに、これらの処理に伴い繰延税金資産 610 億円を取り崩し、総額 1,754 億円の資産圧縮を図りました。これにより、前連結会計年度に引き続き多額の営業損失・四半期純損失を計上し、重要な営業キャッシュ・フローのマイナスが生じました。

現在、今後の事業収益を高めるため、生活創造企業を目指した新たな事業構造改革はもとより、人件費の削減を含む総経費の圧縮、在庫の適正化や資産の売却、設備投資の抑制等により、キャッシュ・フローの創出を実現する経営諸施策の推進に加え、金融機関の支援体制を得て必要な資金枠を確保するとともに、これらの進捗を管理するモニタリング体制を整備し着実に実行しており、平成 25 年 3 月期第 3 四半期連結会計期間において、営業利益は 5 四半期ぶりに黒字転換いたしました。

しかしながら、平成 24 年 12 月末現在の自己資本比率は、9.6%まで低下するに至っており、引き続き早急な財務体質の改善が必要な中、当社は、当社にとって営業利益の安定化にも重要となる液晶事業の顧客として、従前より液晶パネルの供給等で取引関係のあったサムスン電子との間で、昨年末に、当社液晶パネルを長期的かつ安定的に供給することとなりました。そして、サムスン電子との間で、さらに、両社の協業関係のあり方について検討したところ、両社の関係を確固たるものとするためにサムスン電子からの出資を受け入れることが両社の企業価値向上に寄与するとの考えで一致いたしました。割当先については、グループとして資金運用の効率化を図るサムスン電子の意向も踏まえ、両社で協議した結果、サムスン電子の日本法人であるサムスン電子ジャパンといたしました。

本第三者割当増資は、サムスン電子ジャパンを割当先として、出資後の議決権ベースで 3.08%の新株式を発行するものですが、本第三者割当増資の目的は、液晶事業分野で当社とサムスン電子の企業価値向上に寄与する補完関係を強化するため、サムスン電子との協業の確実な推進に向けた信頼関係を構築し、当社液晶パネルを安定的かつ確実に供給していくとともに、当社の自己資本を増強させることにあります。

2. サムスン電子との協業の内容等

当社は現在、サムスン電子に対し、主として世界 No.1 シェア（※）を誇る同社液晶テレビ向けに液晶パネルを供給しております。本資本提携を契機に協業関係をさらに強化し、当社液晶パネルを安定的かつ確実に供給してまいります。特に大型液晶については、サムスン電子の大型テレビ向け液晶パネルを供給するとともに、中小型についてはモバイル機器向け液晶パネル等の供給を拡大してまいります。

※ 出典：ディスプレイサーチ「2012年薄型テレビシェア調査」

3. サムスン電子の概要

①	名 称	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.		
②	所 在 地	416, Maetan 3-dong, Yeongtong-Gu, Suwon, Gyeonggi-do, Korea		
③	代表者の役職・氏名	Vice Chairman & CEO OH-HYUN KWON		
④	事 業 内 容	コンシューマーエレクトロニクス事業、IT及びモバイルコミュニケーション事業		
⑤	資 本 金	897,514,000,000 韓国ウォン（1韓国ウォンを平成24年12月31日の終値0.08154円にて換算した金額は、73,183百万円）		
⑥	設 立 年 月 日	昭和44年1月13日		
⑦	大株主及び持株比率	Samsung life Insurance	6.53%	
		Citibank N.A	6.14%	
		National Pension Service	5.83%	
		Samsung C&T Corporation	3.51%	
		Kun-Hee Lee	2.94%	
⑧	当事会社間の関係			
	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、当社液晶パネルの供給等に関する取引関係があります。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
⑨	最近3年間の経営成績及び財政状態			
決 算 期	平成21年12月期	平成22年12月期	平成23年12月期	
連 結 純 資 産	5,857,495	6,458,152	6,753,363	
連 結 総 資 産	8,995,697	9,706,390	10,319,908	
1株当たり連結当期純資産(円)	34,429	37,960	39,695	
連 結 売 上 高	10,931,795	11,176,680	10,941,267	
連 結 営 業 利 益	876,097	1,250,194	1,077,519	
連 結 当 期 純 利 益	782,699	1,167,071	910,706	
1株当たり連結当期純利益(円)	5,203	7,661	5,906	
1株当たり配当金(円)	642.1	723.3	365.1	

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

- (注) 1. 上記の業績は、1韓国ウォンを、平成21年12月期は、平成21年12月31日の東京外国為替市場終値0.08019円、平成22年12月期は、平成22年12月31日の東京外国為替市場終値0.07228円、平成23年12月期は、平成23年12月30日の東京外国為替市場終値0.06631円にて換算しております。
2. 平成24年12月期の決算は、本日現在未公表のため、記載しておりません。

II. 第三者割当による新株式の発行

1. 募集の概要

① 払込期日	平成25年3月28日
② 発行新株式数	35,804,000株
③ 発行価額	1株につき290円
④ 調達資金の額	10,383,160,000円
⑤ 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法による。 (サムスン電子ジャパン株式会社 35,804,000株)
⑥ その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。

(注) 発行価額は会社法上の払込金額です。

2. 募集の目的及び理由

前記「I. 本資本提携の概要」に記載のとおり、当社は、液晶事業分野で当社とサムスン電子の企業価値向上に寄与する補完関係を強化するため、サムスン電子との協業の確実な推進に向けた信頼関係を構築し、当社液晶パネルを安定的かつ確実に供給していくとともに、当社の自己資本を増強させることを目的として、本第三者割当増資を実施することとしました。

後記「3. (2) 調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、当社は、本第三者割当増資により調達する資金により、液晶ディスプレイの高精細化のための新規技術導入、及びタブレット端末や高精細ノートパソコンといったモバイル機器関連の液晶製造設備の合理化等に係る投資等を行う予定であり、これは、当社グループの中長期的な収益力向上及び競争力強化に資するものと考えております。

また、平成24年11月1日公表の平成25年3月期第2四半期決算及び平成25年2月1日公表の平成25年3月期第3四半期決算において継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、幅広い対応策を実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。しかしながら、平成24年12月末現在の自己資本比率は、9.6%まで低下するに至っており、今回の協業関係強化及び本第三者割当増資は、財務体質改善に向け、当社の資本政策上も有意義なものであると判断しております。また、今後の資本政策については、当社の財務状況に鑑みて、今後の資本の充実に向けたしかるべき検討を行い、企業価値の向上に努めてまいります。

なお、当社は、前記「I. 本資本提携の概要」「1. 本資本提携の目的及び理由」に記載のような新たな事業構造改革の一環として、特に液晶事業の収益力改善・安定化に向けた改革を継続的に推進しており、その具体的な施策として、鴻海精密工業股份有限公司等との包括的な協業を通じた収益の改善・安定化を企図し平成24年3月27日に提出した有価証券届出書に係る鴻海精密工業股份有限公司等を割り当て予定先とする第三者割当増資（以下「平成24年3月27日決議第三者割当増資」といいます。）、Qualcomm Incorporatedの完全子会社との共同開発による次世代ディスプレイ技術といわれるMEMSディスプレイの実用化に向けた平成24年12月4日に提出した有価証券届出書に係るQualcomm Incorporatedを割当先とする第1次及び第2次の第三者割当増資（以下それぞれ「平成24年12月4日決議第1次第三者割当増資」、「平成24年12月4日決議第2次第三者割当増資」といいます。）、並びにサムスン電子への液晶パネルの安定的かつ確実な供給を通じた収益の改善・安定化を企図した本第三者割当増資に取り組んでおります。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

① 払込金額の総額	10,383,160,000円
② 発行諸費用の概算額	249,000,000円
③ 差引手取概算額	10,134,160,000円

- (注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税は含まれておりません。
2. 発行諸費用の概算額の内訳は、登記費用(約37百万円)、弁護士及び財務アドバイザー費用(約176百万円)、取引所上場関係費用(約16百万円)、その他(約20百万円)です。

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額10,134,160,000円の具体的な使途については、次のとおり予定しております。なお、以下の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等で保管する予定です。

具体的な使途	金額	支出予定時期
液晶ディスプレイの高精細化のための新規技術導入	6,900百万円	平成25年4月～ 平成27年3月
タブレット端末や高精細ノートパソコンといったモバイル機器関連の液晶製造設備の合理化等に係る投資等	3,234百万円	平成25年4月～ 平成27年3月

当社は、新たな事業構造改革の一環として、特に液晶事業の収益力改善・安定化に向けた改革を推進しており、その具体的な施策として、当該分野における技術やプロダクトの競争力強化並びに製造・生産等の事業効率の向上を企図した継続的な設備投資等を今後予定しております。

その一環として、モバイル機器向け液晶製造プロセスの内製化を目的とする製造設備の合理化、及び液晶ディスプレイの画素密度の高精細化のための新規技術導入に係わる投資等を計画しており、当該計画の実行に際して必要な資金を調達するため、平成24年3月27日決議第三者割当増資及び本第三者割当増資を決議しております。従って、本第三者割当増資は、上記のとおり平成24年3月27日決議第三者割当増資と実質的に同じ資金使途に基づいて行われるものですが、液晶分野に関連する継続的な設備投資等に鑑み支出予定時期が異なる資金の調達を企図するものです。

加えて、次世代MEMSディスプレイパネル技術・実用化技術の確立のための開発投資等を計画しており、当該計画の実行に際して必要な資金を調達するため、平成24年12月4日決議第1次第三者割当増資及び平成24年12月4日決議第2次第三者割当増資を決議しており、これらは平成24年3月27日決議第三者割当増資及び本第三者割当増資とは異なる資金使途に基づいて行われるものです。

以上のとおり、本第三者割当増資は当社の資本政策に資するものですが、払込みが完了していない平成24年3月27日決議第三者割当増資または平成24年12月4日決議第2次第三者割当増資に代わる資本政策として位置づけるものではありません。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

本第三者割当増資により調達する資金は、前記「2. 募集の目的及び理由」及び「3. (2) 調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、平成25年4月から平成27年3月末に予定する液晶ディスプレイの高精細化のための新規技術導入、及びタブレット端末や高精細ノートパソコンといったモバイル機器関連の液晶製造設備の合理化等に係る投資等に充当するものであります。かかる投資等は、当社グループの中長期的な収益力向上及び競争力強化に資するものであり、ひいては中長期的な当社グループの企業価値及び株主利益の向上に寄与することが見込まれるため、当該資金使途には合理性があるものと判断しております。

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

払込金額につきましては、本第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前営業日である平成 25 年 3 月 5 日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である 299 円を参考とした上で、290 円といたしました。

かかる払込金額は、直近の株式市場の動向等を踏まえ、当社の企業価値が反映されていると判断される本第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前営業日の終値を参考として、割当先と協議の上、直近の当社株価推移や本第三者割当増資により生じる希薄化等を勘案し、上記参考株価から 3%程度のディスカウントとなる金額として決定したものです。

なお、かかる払込金額 290 円は、本第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前営業日である平成 25 年 3 月 5 日の当社株式の終値 299 円に対しては 3.01%のディスカウント、直前営業日から 1 か月遡った期間の終値の単純平均値 316 円に対しては 8.23%のディスカウント、直前営業日から 3 か月遡った期間の終値の単純平均値 304 円に対しては 4.61%のディスカウント、直前営業日から 6 か月遡った期間の終値の単純平均値 237 円に対しては 22.36%のプレミアムを行った金額となります。また、本払込金額は日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠しております。

当社といたしましては、本払込金額は合理的で有利発行に当たらないと判断しており、本第三者割当増資に係る取締役会に出席した当社の監査役 4 名（うち社外監査役 3 名）全員が、上記指針に準拠するものであり、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当増資により、本割当予定先であるサムスン電子ジャパンに対して割り当てる当社普通株式の数量 35,804,000 株は、平成 25 年 3 月 5 日現在の当社普通株式の発行済株式総数 1,140,819,887 株に対して 3.14%（議決権総数 1,125,422 個（注 1）に対する割合 3.18%）となっております。

なお、サムスン電子ジャパンに対して割り当てる当社普通株式の数量 35,804,000 株に、平成 24 年 3 月 27 日決議第三者割当増資により鴻海精密工業股份有限公司等に割り当てる予定の当社普通株式の数量 121,649,000 株並びに平成 24 年 12 月 4 日決議第 1 次第三者割当増資により Qualcomm Incorporated に割り当てた当社普通株式の数量 30,120,000 株及び平成 24 年 12 月 4 日決議第 2 次第三者割当増資により Qualcomm Incorporated に割り当てる予定の当社普通株式の数量 17,577,000 株（注 2）を加えた総数 205,150,000 株は、平成 25 年 3 月 5 日現在の当社普通株式の発行済株式総数 1,140,819,887 株から平成 24 年 12 月 4 日決議第 1 次第三者割当増資により発行した当社普通株式の数量 30,120,000 株を除いた 1,110,699,887 株に対して 18.47%（議決権総数 1,095,302 個に対する割合 18.73%）となっております。

（注 1）発行済株式総数 1,140,819,887 株から、平成 24 年 9 月 30 日時点の株主名簿に基づく単元未満株式 4,939,887 株、自己保有株式（単元未満株式を除く）10,383,000 株及び相互保有株式 75,000 株を控除して算出

（注 2）Qualcomm Incorporated による払込金額の予定総額である 60 百万 US ドルを、平成 25 年 3 月 5 日の東京外国為替市場における US ドル終値 93.16 円及び平成 25 年 3 月 5 日から遡った 20 営業日の間の株式会社東京証券取引所における当社の終値の単純平均値（1 円未満の端数は切り上げ）に相当する額で除して算出（1,000 株未満の端数は切り捨て）

しかしながら、前記「I. 本資本提携の概要」「1. 本資本提携の目的及び理由」及び「3.（2）調達する資金の具体的な用途」に記載のとおり、本第三者割当増資は、当社とサムスン電子との協業の確実な推進に向けた信頼関係の構築及び当社の自己資本の増強に貢献するものであり、また、本第三者割当増資により調達する資金を液晶ディスプレイの高精細化のための新規技術導入、及びタブレット端末や高精細ノートパソコンといったモバイル機器関連の液晶製造設備の合理化等に係る投資等に充当することで、中長期的な当社グループの企業価値及び株主利益の向上に寄与することが見込まれることから、本第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的と判断しております。

6. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

①	名 称	サムスン電子ジャパン株式会社		
②	所 在 地	東京都千代田区九段北四丁目2番1号		
③	代表者の役職・氏名	代表取締役 方常源		
④	事 業 内 容	通信基盤設備事業、携帯端末輸入販売事業 等		
⑤	資 本 金	1億円		
⑥	設 立 年 月 日	平成20年9月2日		
⑦	発 行 済 株 式 数	20万株		
⑧	決 算 期	12月		
⑨	従 業 員 数	301名(平成24年12月末)		
⑩	主 要 取 引 先	株式会社エヌ・ティ・ティ・コム、KDD I 株式会社		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社三菱東京UFJ銀行		
⑫	大株主及び持株比率	SAMSUNG ELECTRONICS ASIA HOLDING PTE. LTD. 100%		
⑬	当事会社間の関係			
	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。なお、当社と当該会社の親会社であるサムスン電子との間には、当社液晶パネルの供給等に関する取引関係があります。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
⑭	最近3年間の経営成績及び財政状態			
決 算 期	平成22年12月期	平成23年12月期	平成24年12月期	
純 資 産	3,105	5,647	8,714	
総 資 産	26,034	51,429	81,654	
1株当たり当期純資産(円)	15,524	28,233	43,568	
売 上 高	76,586	150,601	205,180	
営 業 利 益	3,079	4,490	5,280	
当 期 純 利 益	1,756	2,542	3,067	
1株当たり当期純利益(円)	8,781	12,709	15,334	
1株当たり配当金(円)	-	-	-	

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(注) 本割当予定先であるサムスン電子ジャパンの親会社であるサムスン電子（サムスン電子ジャパンの完全親会社であるSAMSUNG ELECTRONICS ASIA HOLDING PTE. LTD.の完全親会社）は、韓国取引所、ロンドン証券取引所及びブルクセンブルク証券取引所に上場しております。なお、当社は、本割当予定先並びに当該割当予定先の役員及び主要株主が暴力団等とは一切関係がないことを、本割当予定先の表明及び同社の親会社であるサムスン電子との面談等を通じて確認しております。これにより、当社は、本割当予定先並びに本割当予定先の役員及び主要株主が暴力団等とは一切関係がないと判断しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所に提出しております。

(2) 割当予定先を選定した理由

割当予定先を選定した理由については、前記「I. 本資本提携の概要」「1. 本資本提携の目的及び理由」をご参照下さい。

(3) 割当予定先の保有方針

当社は、割当予定先から、当社への投資の目的は、液晶事業分野で当社とサムスン電子の企業価値向上に寄与する補完関係を強化するため、当社との協業の確実な推進に向けた信頼関係を構築することにより、当該目的のためにサムスン電子の一員として当社株式を保有するとの説明を受けております。なお、当社は、割当予定先より、本第三者割当増資の割当日から2年以内に当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に報告すること、並びに当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所に報告すること及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

(4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社としては、本割当予定先であるサムスン電子ジャパンから書面により提出された同社の平成24年12月末日時点の貸借対照表（監査済み）及び同社の親会社であるサムスン電子に対する当該貸借対照表の内容に係るヒアリングを通じて、サムスン電子ジャパンが保有する資産の流動性も踏まえ、同社が十分な資金力を有していることが確認できることから、本第三者割当増資の払込みについて問題はないと判断しております。

7. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成24年12月31日現在）		募集後	
日本生命保険相互会社	4.88%	日本生命保険相互会社	4.73%
明治安田生命保険相互会社	4.01%	明治安田生命保険相互会社	3.89%
株式会社みずほコーポレート銀行	3.67%	株式会社みずほコーポレート銀行	3.56%
株式会社三菱東京UFJ銀行	3.65%	株式会社三菱東京UFJ銀行	3.54%
三井住友海上火災保険株式会社	2.69%	サムスン電子ジャパン株式会社	3.04%
Qualcomm Incorporated	2.64%	三井住友海上火災保険株式会社	2.61%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2.48%	Qualcomm Incorporated	2.56%
シャープ従業員持株会	2.45%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2.41%
株式会社損害保険ジャパン	1.88%	シャープ従業員持株会	2.38%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1.79%	株式会社損害保険ジャパン	1.83%

(注) 募集前の持株比率については、平成24年9月30日現在の株主名簿を基準として、平成24年12月4日決議第1次第三者割当増資による発行新株式30,120,000株を加算して記載しており、募集後の持株比率については、平成24年9月30日現在の株主名簿を基準として、平成24年12月4日決議第1次第三者割当増資による発行新株式30,120,000株を加算し、かつ、平成24年3月27日決議第三者割当増資及び平成24年12月4日決議第2次第三者割当増資に基づく新規発行株式の払込みが行われていないことを前提として、本第三者割当増資による異動を反映しております。

8. 今後の見通し

本資本提携が平成25年3月期の連結業績に与える影響につきましては、軽微であります。また、平成26年3月期の連結業績に与える影響につきましては、当該業績見通し公表時に織り込んで開示する予定です。なお、本資本提携に関し今後開示すべき事実が生じましたら、速やかに開示いたします。

9. 企業行動規範上の手続に関する事項

本第三者割当増資は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条、株式会社大阪証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第 2 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。

10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（連結）

	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
売上高	2,755,948 百万円	3,021,973 百万円	2,455,850 百万円
営業利益又は営業損失(△)	51,903 百万円	78,896 百万円	△37,552 百万円
経常利益又は経常損失(△)	30,995 百万円	59,124 百万円	△65,437 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)	4,397 百万円	19,401 百万円	△376,076 百万円
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)	4.00 円	17.63 円	△341.78 円
1株当たり配当金	17.00 円	17.00 円	10.00 円
1株当たり純資産	949.19 円	932.46 円	568.83 円

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 25 年 3 月 5 日現在）

	株式数	発行済普通株式数に対する比率
発行済株式数	1,140,819,887 株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数	79,018,964 株	6.9%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—	—
上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—	—

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
始値	799 円	1,172 円	824 円
高値	1,253 円	1,260 円	842 円
安値	771 円	626 円	467 円
終値	1,169 円	825 円	604 円

(注) 株価は東京証券取引所市場第一部による。

② 最近6か月間の状況

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
始値	195 円	167 円	170 円	310 円	326 円	295 円
高値	198 円	181 円	372 円	352 円	357 円	307 円
安値	142 円	147 円	170 円	281 円	286 円	294 円
終値	172 円	172 円	303 円	311 円	294 円	299 円

(注) 1. 株価は東京証券取引所市場第一部による。
2. 平成 25 年 3 月の株価については、平成 25 年 3 月 5 日現在で表示しております。

③ 発行決議日前取引日における株価

	平成 25 年 3 月 5 日
始値	301 円
高値	302 円
安値	299 円
終値	299 円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

平成24年3月27日決議第三者割当増資（払込期間：平成24年5月31日から平成25年3月26日まで）を平成24年3月27日に公表しておりますが、本日現在払込みはなされておられません。なお、当社は割当予定先との間で協議を継続しております。

また、当社は、平成24年12月4日決議第1次第三者割当増資（払込期日：平成24年12月27日）及び平成24年12月4日決議第2次第三者割当増資（払込期日：平成25年3月29日）を平成24年12月4日に公表しておりますが、平成24年12月4日決議第2次第三者割当増資については、当社は割当予定先との間で協議を継続しております。

各第三者割当増資公表時の募集内容等は以下のとおりであります。

<平成24年3月27日決議第三者割当増資>

払込期間	平成24年5月31日から平成25年3月26日まで
調達資金の額	66,466,950,000円（差引手取概算額）
発行価額	1株につき550円
募集時における発行済株式総数	1,110,699,887株
当該募集による発行株式数	121,649,000株
募集後における発行済株式総数	1,232,348,887株
割当予定先	鴻海精密工業股份有限公司 50,000,000株 鴻準精密工業股份有限公司 8,029,000株 FOXCONN (FAR EAST) Limited 31,143,000株 Q-Run Holdings Limited 32,477,000株
発行時における当初の資金使途	モバイル機器関連の液晶製造設備の増強・合理化、及び液晶ディスプレイの新規技術導入に係わる投資等
発行時における支出予定時期	平成24年5月～平成26年4月
現時点における充当状況	該当事項はありません。

<平成24年12月4日決議第1次第三者割当増資>

払込期日	平成24年12月27日
調達資金の額	4,711,680,000円（差引手取概算額）
発行価額	1株につき164円
募集時における発行済株式総数	1,110,699,887株
当該募集による発行株式数	30,120,000株
募集後における発行済株式総数	1,140,819,887株
割当先	Qualcomm Incorporated 30,120,000株
発行時における当初の資金使途	次世代MEMSディスプレイの開発経費及び開発用設備投資
発行時における支出予定時期	平成24年12月～平成25年3月
現時点における充当状況	当初の資金使途に従い一部充当しております。

<平成24年12月4日決議第2次第三者割当増資>

払込期日	平成25年3月29日
調達資金の額	未定
発行価額	未定
募集時における発行済株式総数	1,110,699,887株
当該募集による発行株式数	未定
募集後における発行済株式総数	未定
割当予定先	発行される株式すべてをQualcomm Incorporatedに割り当てる予定
発行時における当初の資金使途	次世代MEMSディスプレイ生産技術開発経費及び生産技術開発用設備投資
発行時における支出予定時期	平成25年4月～平成26年9月
現時点における充当状況	該当事項はありません。

1 1. 発行要項

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) 募集株式の数 | 35,804,000株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき290円 |
| (3) 払込金額の総額 | 10,383,160,000円 |
| (4) 増加する資本金の額 | 5,191,580,000円 |
| (5) 増加する資本準備金の額 | 5,191,580,000円 |
| (6) 募集又は割当方法
(割当予定先及び
割当予定株数) | 第三者割当の方法による。
(サムスン電子ジャパン株式会社 35,804,000株) |
| (7) 払込期日 | 平成25年3月28日 |
| (8) その他 | 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |

以 上